# TPCA Show TAIPEI

Energy efficient AI
from Cloud to the Edge

**10.24 限定 展場好康大放送！**
**Lucky Draw on the 24th Only!**
現場好禮抽獎與冰淇淋派對
最終辦法請依官網為主

台灣電路板產業國際展覽會 PCB
台灣電子組裝/SMT國際展覽會 SMT
台灣電子構裝國際展覽會 IC PACKAGING
台灣綠色科技國際展覽會 GREEN TECH
台灣熱管理技術國際展覽會 THERMAL

立即登錄參觀
tpcashow.com

INVITED BY H-0000 BOOTH NO. H-0000

# 招待狀

**2025 OCT. 22 WED-24 FRI.**
台北南港展覽館一館（一樓、四樓）TaiNEX 1, TAIPEI
**10:00 – 17:00**（Final Day 15:00）

## 特別展示 Special Exhibition

### 終端應用 End Applications
- 電腦 Computing
- 航太/軍用 Aerospace and Defense
- 通訊 Communication
- 消費性電子 Consumer Electronics
- 車載 Automotive

### AI與智能製造應用 AI and intelligent manufacturing applications
- AI封裝檢測 AI package inspection
- AI軟體開發 AI software development
- Edge AI
- 機器人 robot

### 熱管理與熱像應用 Thermal management and thermal imaging applications
- 紅外線感測器製程 Infrared sensor process
- 模組封裝 Module packaging
- 光學系統及產品應用 Optical systems and product applications

### 先進製程與高階封裝 Advanced Processes and Advanced Packaging
- CoWos , CoPos
- FOPLP
- TGV & Glass Core

以上展商僅為隨機呈現，完整名單請上網查詢 all exhibitors are on www.tpcashow.com

全球電子產業正在加速跨界融合，從PCB、SMT、載板到高階封裝與半導體製程，規模再創歷史新高，逾670+國際品牌、1750個攤位，TPCA Show正是您一站式掌握供應鏈最新技術、材料與夥伴的最佳平台。我們誠摯邀請您於2025年10月22日至24日親臨台北南港展覽館一館，與來自全球的技術專家、創新企業及潛在合作夥伴共聚盛會。

TPCA Show is the leading international exhibition bridging the entire value chain from PCBs, SMT, thermal solutions, substrates to advanced packaging and AI-driven manufacturing. Join us in Taipei and explore what's next.

## 9大主題分區
IC Substrates, Thermal, Green Tech, Automation, etc.

- 載板與高階電路板製造本業區 IC Substrate & PCBs
- 光電專區 OPTO Pavillion
- 乾、溼製程設備 Dry & Wet Process Equipment
- 智動化解決方案 Automation Equipment
- 高質新材料、耗材與化學品 Materials & Chemicals
- 綠色科技區 Green Tech
- SMT/熱管理技術 SMT / Thermal Management
- 檢測設備與軟體 Testing Equipment
- 矽光子專區 HiSPA Pavillion

更多訊息請至官網 For more information Website：www.tpcashow.com

## 活動介紹 Activity

- 開幕典禮暨主題演講《產業領航者的AI供應鏈戰略》Opening Ceremony & Keynote: "AI-Driven Supply Chain Strategies by Industry Leaders"
- 產業領袖高峰會 CEO Summit：與決策者直接對話
- 半導體與PCB異質整合高峰論壇：Semiconductor X PCB Summit
- 洞察未來趨勢 Tech X Total solution
  - Pack Vision 封裝視界（CoWoS, CoPoS, Packaging, IC Substrates...）
  - Smart Link 智聯製造（AI、IoT、數智製造、機器人、AI檢測與軟體...）
  - Next Core 次世代核心（TGV、Glass Core、FoPLP...）
  - Hyper Edge 高速邊緣（HPC、5G、伺服器、熱管理與應用）
  - Auto Next 車用科技（EV與車用電子）
  - Green Tech 綠能科技（永續與淨零）
- 人才原力媒合=電路板 X Z世代人才 Digital Talent Match Day

鼓勵搭乘大眾交通工具，攜手減碳共創環境永續，一起參與綠色看展！
Take rapid transportation, make this world green.

謝絕18歲以下及非相關行業民眾入場參觀。
Under 18 not admitted.

IMPACT Oct. 21-24
International Microsystems, Packaging, Assembly and Circuits Technology conference
www.impact.org.tw